

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-150967

(43)Date of publication of application : 30.05.2000

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

(21)Application number : 11-303910

(71)Applicant : AGILENT TECHNOL INC

(22)Date of filing : 26.10.1999

(72)Inventor : CAREY JULIAN A
COLLINS III WILLIAM D
LOH BAN POH
SASSER GARY D

(30)Priority

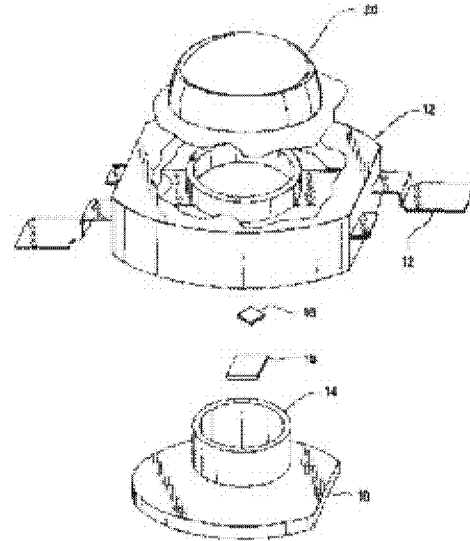
Priority number : 98 187547 Priority date : 05.11.1998 Priority country : US

(54) SURFACE-MOUNTABLE LED PACKAGE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable an LED package to optically highly efficiently operate by arranging slag composed of a heat-conductive material on the pedestal of a cavity and, at the same time, a lens in a lead frame opposite to the cavity.

SOLUTION: An LED(light emitting diode) die 16 is directly or indirectly mounted on slag 10 which becomes a heat sink through a high heat-conductivity auxiliary pedestal 18. Then bonding wires are extended from the LED die 16 and auxiliary pedestal 18 until the wires reach the metallic leads of a lead frame 12 insert-molding the slag 10 in a state where the lead frame 12 is electrically and thermally isolated from the slag 10 and inserted into the lead frame 12. In addition, a lens 20 which makes optical activity is arranged in the lead frame 12 opposite to a cavity. Therefore, an LED can optically highly efficiently operate.



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-150967
(P2000-150967A)

(43) 公開日 平成12年5月30日 (2000.5.30)

(51) Int.Cl.⁷
H 0 1 L 33/00

識別記号

F I
H 0 1 L 33/00

テーマコード* (参考)

N

審査請求 未請求 請求項の数19 O L (全 5 頁)

(21) 出願番号 特願平11-303910

(22) 出願日 平成11年10月26日 (1999. 10. 26)

(31) 優先権主張番号 1 8 7 5 4 7

(32) 優先日 平成10年11月5日 (1998. 11. 5)

(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 399117121

アジレント・テクノロジーズ・インク
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

アメリカ合衆国カリフォルニア州パロアルト
ページ・ミル・ロード 395

(72) 発明者 ジュリアン・エー・カレイ

アメリカ合衆国カリフォルニア州サニーヴ
ェイル イースト レミントン ドライブ
575 アパートメント 6エー

(74) 代理人 100105913

弁理士 加藤 公久

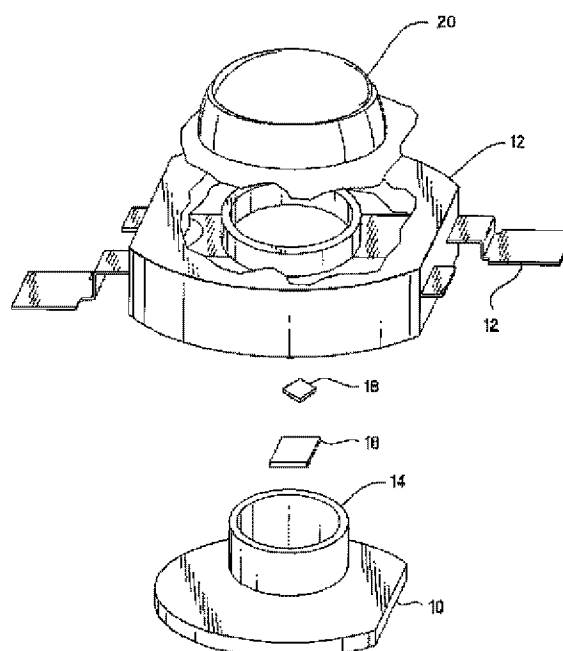
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表面実装可能なLEDパッケージ

(57) 【要約】

【課題】信頼性が高く、発光効率の高い動作が実現できるLEDパッケージを提供する。

【解決手段】LEDダイ16は、副基台18を介してスラグ10に支持される。スラグ10及び副基台18は熱伝導性が良好なので、LEDダイ16の動作による熱が効果的に拡散される。従って、LEDダイ16は熱による特性劣化を生じにくい。



【特許請求の範囲】

【請求項1】キャビティを有し、構造的一体性を与えるよう作用するリードフレーム、前記キャビティの基台に配置された、熱伝導性材料からなるスラグ、及び前記リードフレームの内部で前記キャビティに対向して配置され、光学的機能を提供するレンズを備えることを特徴とするLEDダイ用のパッケージ。

【請求項2】前記スラグに結合された、熱伝導性材料から成る副基台を更に備えることを特徴とする請求項1に記載のパッケージ。

【請求項3】前記副基台のための前記熱伝導性材料は、銀、銅、ダイヤモンド、シリコン、アルミニウム、タンダステン、モリブデン、及びベリリウムの純粋材料、化合物、及び複合物から成る群から選択される材料を含むことを特徴とする請求項2に記載のパッケージ。

【請求項4】前記スラグのための前記熱伝導性材料は、銀、銅、ダイヤモンド、シリコン、アルミニウム、タンダステン、モリブデン、及びベリリウムの純粋材料、化合物、及び複合物から成る群から選択される材料を含むことを特徴とする請求項1に記載のパッケージ。

【請求項5】前記スラグに熱的に結合されるLEDダイ、及びショア10Aより小さい硬度を有し、前記LEDダイをカプセル封入する光学的に透明な材料を更に備えることを特徴とする請求項1に記載のパッケージ。

【請求項6】前記スラグに熱的に結合されるLEDダイ、及び少なくともショア50Dの硬度を有する光学的に透明なカプセル材を更に備えることを特徴とする請求項1に記載のパッケージ。

【請求項7】前記LEDダイと前記スラグとの間に結合された、熱伝導性材料から成る副基台を備えることを特徴とする請求項5に記載のパッケージ。

【請求項8】前記副基台のための熱伝導性材料は、銀、銅、ダイヤモンド、シリコン、アルミニウム、タンダステン、モリブデン、及びベリリウムの純粋材料、化合物、及び複合物から成る群から選択されることを特徴とする請求項7に記載のパッケージ。

【請求項9】前記スラグのための熱伝導性材料は、銀、銅、ダイヤモンド、シリコン、アルミニウム、タンダステン、モリブデン、及びベリリウムの純粋材料、化合物、及び複合物から成る群から選択されることを特徴とする請求項5に記載のパッケージ。

【請求項10】反射面を有し、前記スラグの近くに配置された、反射カップを備えることを特徴とする請求項5に記載のパッケージ。

【請求項11】前記反射カップは、前記リードフレームに組み込まれていることを特徴とする請求項10に記載のパッケージ。

【請求項12】前記反射カップは、銀、アルミニウム、金、誘電体被覆された銀、誘電体被覆された金、及び誘

電体被覆されたアルミニウムから成る群から選択される材料を含むことを特徴とする請求項11に記載のパッケージ。

【請求項13】前記反射カップの反射面は、銀、アルミニウム、金、誘電体被覆された銀、誘電体被覆された金、及び誘電体被覆されたアルミニウムから成る群から選択される材料を含むことを特徴とする請求項12に記載のパッケージ。

【請求項14】前記反射面は、0.3より大きな屈折率の階段状変化によって形成される少なくとも一つの内部全反射面を備えることを特徴とする請求項12に記載のパッケージ。

【請求項15】反射面を有し、前記スラグの近くに配置された、反射カップを更に備えることを特徴とする請求項1に記載のパッケージ。

【請求項16】前記反射カップは、前記リードフレームに組み込まれていることを特徴とする請求項15に記載のパッケージ。

【請求項17】前記反射カップは、銀、アルミニウム、金、誘電体被覆された銀、誘電体被覆された金、及び誘電体被覆されたアルミニウムから成る群から選択される材料を含むことを特徴とする請求項16に記載のパッケージ。

【請求項18】前記反射面は、銀、アルミニウム、金、誘電体被覆された銀、誘電体被覆された金、及び誘電体被覆されたアルミニウムから成る群から選択される材料を含むことを特徴とする請求項17に記載のパッケージ。

【請求項19】反射面は0.3より大きな屈折率の階段状変化により形成される少なくとも一つの内部全反射面を備えることを特徴とする請求項17に記載のパッケージ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、発光ダイオードのパッケージ化に関し、特に表面実装に好適な構造を含むパッケージに関する。

【0002】

【従来の技術】多くの発光ダイオード(LED)はコヒーレントでない光を発光する。LEDの性能の一つの尺度は、例えば入力エネルギーの可視光への変換等の光度測定から導かれるような発光効率である。発光効率は、LEDの接合部の温度に反比例する。LEDパッケージの設計者の主要関心事は、LEDダイを比較的低い温度に維持して全体の性能を改善することである。

【0003】例えば、消費電力が200mW以下であるか又は面積の小さいLEDダイによる低消費電力のLEDでは、光学キャビティの寸法が大きいために所望の信頼性条件に合致しない。キャビティ寸法が最適値より小さいと、光抽出効率、即ち装置からの発光量が減少す

る。従来技術のパッケージ、例えばT1-3/4及びスナップLEDは、硬いカプセル材として成形エポキシ材料を使用している。成形エポキシ材料は、光学的及び構造的に有効である。LEDパッケージの従来技術による装置を図1に示す。LEDダイは光学キャビティの基台上に載置される。硬いカプセル材、例えば、剛性を有する未充填エポキシ材料が光学キャビティを埋めている。LEDダイ、光学キャビティ、及びカプセル材の熱膨張係数は互いに異なるので、動作中にそれらは異なる割合で膨張し収縮する。このためLEDに対して比較的大きな機械的応力加わる。加えて、従来技術のパッケージは、電気導線が主な熱伝導経路であるため熱伝導経路と電気経路との間で熱的経路が分離されていない。その結果、パッケージ化されたLEDダイは、特に最終製品への組立の工程で温度サイクルによる熱的応力を受けやすい。

【0004】これらの問題は、ダイの面積又は入力側電力が増大するにつれて更に悪化する。接合面積が大きい（例えば、 0.25mm^2 より大きい）LEDダイは、同等の光抽出効率を与えるのに、接合面積が小さい（例えば、 0.25mm^2 より小さい）LEDダイより、大きな光学素子部品を必要とするので、必要とされる光学キャビティも大きくなる。LEDに加わる機械的応力は、カプセル材の体積と共に増大する。加えて、応力はパッケージ化されたLEDが温度サイクル及び高温度状態にさらされるにつれて増大する。機械的応力が蓄積するとLEDの全体としての信頼性が低下する。

【0005】従来技術のパッケージは主要熱伝導経路としてそれらの電気導線を使用しているから、これらの経路は熱伝導に対して高い抵抗を有し、電力消費が増大（例えば、 200mW 以上）するとき、外部装置の高い熱伝導抵抗の影響を受けてその接合温度が高くなってしまふ。高い接合温度は、LEDチップの発光効率の不可逆的劣化を加速する原因となり、またLEDパッケージの機械的一体性を損なう原因となるプロセスを加速する。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】特に高い（35%）デューティ係数で又は長いパルス幅（1秒より長い）で動作するとき、LED平均入力側電力が 0.2W 程度で、信頼性が高く、光学的に高い効率の動作が実現できるLEDパッケージは存在しない。本発明はこのようなLEDパッケージを提供することを目的としている。

【0007】

【課題を解決するための手段】本発明は、光学的機能と構造的機能とが別々になっているLEDパッケージを提供する。ヒートシンクとなるスラグがインサートモールドされたリードフレームに挿入される。インサートモールドされたリードフレームは、構造的な一体性を与えるように打ち抜きによりパターン形成された金属部品を埋め込みプラスチック材料によってオーバーモールドして構

成している。スラグは、随意選択の反射カップを備えることができる。LEDダイは、電気絶縁性を有し且つ良好な熱伝導性を有する副基台を介して直接的又は間接的にスラグに取り付けられている。ボンディングワイヤは、LEDから延びてスラグに対して電氣的及び熱的に分離された金属リードまで延長される。光学レンズは、熱可塑性材料によって予備成形された光学的に透明なレンズ及び柔らかい光学的に透明なカプセル材を取付けることにより、又はLEDを覆うように光学的に透明なエポキシ材料を成形することにより、又は柔らかい光学的に透明なカプセル材の上に光学的に透明のエポキシを成形することにより製造可能である。柔らかい光学的に透明なカプセル材は、LEDダイに与える応力を小さくでき又は衝撃吸収を提供できるような柔らかい材料である。

【0008】

【発明の実施の形態】図2は、本発明によるLEDパッケージ、即ち光学的機能及び構造的機能を分離したLEDパッケージの一実施形態を示す。ヒートシンクとなるスラグ10はインサートモールドされたリードフレーム12に挿入される。インサートモールドされたリードフレーム12は、電氣的なパスを与える金属フレームの周りに成形された埋め込みプラスチック材料を有する。スラグ10は、随意選択の反射カップ14を備えることができる。発光ダイオード（LED）ダイ16は熱伝導性の良好な副基台18を介して、直接的に又は間接的に、スラグ10に取り付けられている。ボンディングワイヤがLED16及び副基台18から延び、スラグ10に対して電氣的に且つ熱的に分離されたリードフレーム12の金属リードまで達する。熱可塑性材料によって予備成形されるレンズ及びカプセル材（図示せず）を取付けることにより、又はLEDを覆うようにエポキシ材を成形することにより、又はカプセル材（図示せず）の上にエポキシ材によるレンズを成形することにより、光学レンズ20を付加することができる。カプセル材は、好適にはLEDダイに加わる応力を小さくできるか又は衝撃吸収を与えることのできる柔らかい材料である。LEDダイは、ヒートシンクとなるスラグに熱的に結合しているので、ダイは従来のパッケージより低い接合温度に維持され得る。動作温度が低くなれば、ダイは大きな熱応力を受けないので、大電力動作によっても信頼性及び良好な特性を維持できる。

【0009】ヒートシンクとなるスラグ10は、リードフレーム12から熱的に分離される。絶縁体から成る副基台18を使用すれば、スラグ10は電氣的に絶縁され、従って、スラグ10は最小の熱抵抗で外部ヒートシンク（図示せず）に結合されるのでパッケージ内の熱の蓄積を防止することができる。体積の大きなスラグ10は、LEDダイ16から遠くに熱を伝導させるための熱抵抗の小さなパスを提供する。好適実施形態では銅のス

ラグを使用しているが、他の適切な材料にはダイヤモンド、シリコン、アルミニウム、モリブデン、窒化アルミニウム、酸化アルミニウム、又はそれらの複合物及び合金等がある。更に、モリブデン・銅及びタングステン・銅の複合物も使用可能である。

【0010】副基台18は、スラグ材料とLEDダイとの間の熱伝導経路及び熱膨張の緩衝（バッファ）としても機能する。好ましくは、副基台18はLEDダイと同等の熱膨張係数を備える。副基台18は導電性又は絶縁性のいずれの材料であっても良い。

【0011】インサートモールドされたリードフレーム12は、打ち抜き加工されてパターン形成された金属部品であり、高い導電率を与えるがその熱伝導率は低い。リードフレーム12は低い熱伝導率及び電氣的絶縁性を与えるプラスチック構造部品によりオーバーモールドされ得る。リードフレームの絶縁部分は構造的な一体性を与える埋込みプラスチック材料である。強度の大きなプラスチック本体は、パッケージの構造的な一体性を与え、ジュロ硬度がショア約50乃至90Dである。光学的及び構造的機能を分離することによりパッケージがその構造的な一体性を犠牲にせず光学的特性を維持することができる。

【0012】カプセル材は、屈折率が1.3より大きな柔らかい光学的に透明な材料、例えば、シリコン、液状又はゼラチン質の光学化合物材料であり、LEDダイ16と光学レンズ20との間の光路を埋める。柔らかい光学的に透明な材料は、LEDダイ16を保護する。柔らかいカプセル材のジュロ硬度はショア10Aより小さい。

【0013】随意選択の反射カップ14は、反射率を上げるためにめっきされる熱伝導性の良好な材料から作られている。随意選択の反射カップ14は反射率を高めるために被覆してある熱伝導性の良好な材料から作ることができる。反射カップの光学面が構成できる適切な熱伝導材料は、スラグ10と同様に、銀、銅、アルミニウム、モリブデン、ダイヤモンド、シリコン、アルミナ、窒化アルミニウム、酸化アルミニウム、及びそれらの複合物がある。スラグ10と異なり、反射カップの壁は、熱的絶縁材料、例えば、反射被膜付きプラスチック材料から製造可能である。他の場合には、壁は、外部の光学表面がチップから表面への光線の入射角及び表面における高い屈折率から低い屈折率への階段状変化のために生じる内部全反射（TIR）によって反射面を与えるように配置された、光学プラスチックレンズシェルの被覆されない表面で形成してもよい。屈折率の階段状変化は0.3以上とされる。

【0014】多数の好適実施形態においてカップは銀で被覆される。しかしながら、アルミニウム、金、プラチナ、及びアルミニウム、銀、金、又は純粋な誘電体のスタック構造のような他の反射材料被膜を使用してもよ

い。

【0015】本発明を上記の実施形態に沿って説明すると、本発明は、キャビティを有し、構造的な一体性を与えるよう作用するリードフレーム（12）、前記キャビティの基台に配置された、熱伝導性材料からなるスラグ（10）、前記リードフレーム（12）の内部で前記キャビティに対向して配置され、光学的機能を提供するレンズ（20）を備えることを特徴とするLEDダイ用のパッケージを提供する。

10 【0016】好ましくは、スラグ（10）に結合された、熱伝導性材料から成る副基台（18）を更に備える。

【0017】好ましくは、副基台（18）のための熱伝導性材料は、銀、銅、ダイヤモンド、シリコン、アルミニウム、タングステン、モリブデン、及びペリリウムの純粋材料、化合物、及び複合物から成る群から選択される。

20 【0018】好ましくは、スラグ（10）のための熱伝導性材料は、銀、銅、ダイヤモンド、シリコン、アルミニウム、タングステン、モリブデン、及びペリリウムの純粋材料、化合物、及び複合物から成る群から選択される。

【0019】好ましくは、スラグ（10）に熱的に結合されるLEDダイ（16）、及びショア10Aより小さい硬度を有し、LEDダイをカプセル封入する光学的に透明な材料を更に備える。

30 【0020】好ましくは、スラグ（10）に熱的に結合されるLEDダイ（16）、及び少なくともショア50Dの硬度を有する光学的に透明なカプセル材を更に備える。

【0021】好ましくは、LEDダイ（16）とスラグ（10）との間に結合された、熱伝導性の副基台（18）を備える。

【0022】好ましくは、反射面を有し、スラグ（10）の近くに配置された、反射カップ（14）を備える。

【0023】好ましくは、反射カップは、リードフレームに組み込まれている。

40 【0024】好ましくは、反射カップ（14）は、銀、アルミニウム、金、誘電体被覆された銀、誘電体被覆された金、及び誘電体被覆されたアルミニウムから成る群から選択される材料を含む。

【0025】好ましくは、反射カップの反射面は、銀、アルミニウム、金、誘電体被覆された銀、誘電体被覆された金、及び誘電体被覆されたアルミニウムから成る群から選択される材料を含む。

【0026】好ましくは、反射面は、0.3より大きな屈折率の階段状変化によって形成される少なくとも一つの内部全反射面を備える。

50 【0027】好ましくは、反射面を有し、スラグの近く

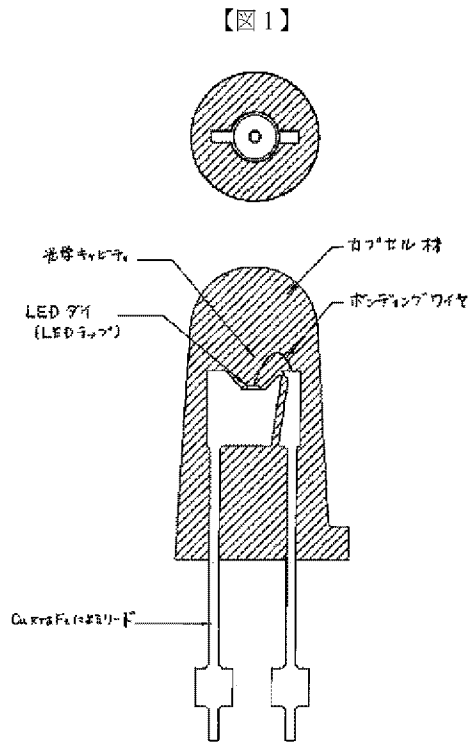
に配置された、反射カップ（14）を更に備える。

【0028】本実施形態で示したLEDパッケージは、あくまでも例示的なものであり、本発明を制限するものではなく、当業者によって更に様々な変形、変更が可能である。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術のLEDパッケージを示す頂側及び側方から見た断面図である。

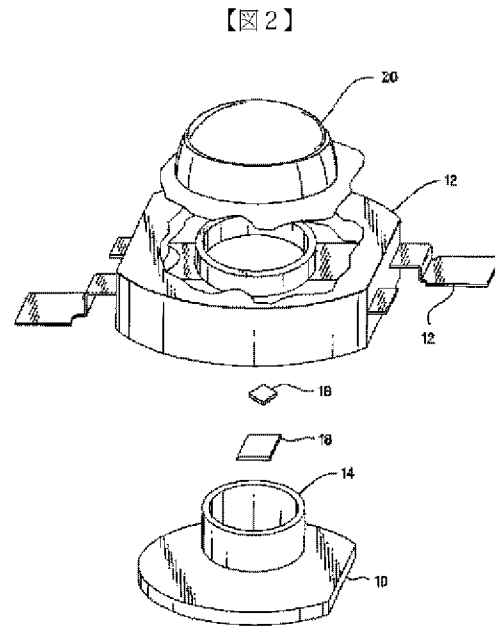
【図2】本発明のLEDパッケージの一実施形態を示す*



*斜視図である。

【符号の説明】

- 10 スラグ
- 12 リードフレーム
- 14 反射カップ
- 16 LEDダイ
- 18 副基台
- 20 レンズ



フロントページの続き

(71)出願人 399117121

395 Page Mill Road P
alo Alto, California
U. S. A.

(72)発明者 ウィリアム・ディー・コリンズ, サード
アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ
ケイリーン ドライブ 3435

(72)発明者 バン・ポー・ロー

アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ
ケイプ タウン プレイス 823

(72)発明者 ゲイリー・ディー・ササー

アメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ
マクダニエル アベニュー 1510